# プラズマMOCVD装置の開発とInP薄膜結晶成長

梅野正義・内藤正美・鈴木孝之・曽我哲夫 神保孝志・松本 功\*・加藤匡也\*

電気情報工学科

(1988年9月3日受理)

# InP Epitaxial Growth using a Newly Developed Plasma MOCVD System

Masayoshi UMENO · Masami NAITOH · Takayuki SUZUKI · Tetsuo Soga Takashi JIMBO · Koh MATSUMOTO<sup>\*</sup> and Masaya KATOH<sup>\*</sup> Department of Electrical and Computer Engineering

(Received September 3, 1988)

The use of highly toxic gases such as  $AsH_3$  and  $PH_3$  in metalorganic chemical vapor deposition (MOCVD) is not desirable. To avoid such toxic gases, we replaced the conventional hydride gas by the group V element and  $H_2$  plasma. In this paper, we report on a new MOCVD apparatus which uses a solid source for the group V element and the growth of InP using red-phosphorus and  $H_2$  plasma.

In the growth using PH<sub>3</sub>, the carrier concentration and the Hall mobility of InP were  $7.2 \times 10^{14}$  cm<sup>-3</sup> and 87000 cm<sup>2</sup>/V·s at 77K, respectively.

In the growth using red-phosphorus, the carrier concentration and the Hall mobility of InP were  $1.6 \times 10^{16}$  cm<sup>-3</sup> and 7100 cm<sup>2</sup>/V·s at 77K, respectively. The InP layers grown using red-phosphorus and H<sub>2</sub> plasma, however, were contaminated by impurities.

## 1. はじめに

GaAs や InP を中心とした化合物半導体は、高移動度、 直接遷移型の特徴を持つものがあり、Si にはない面が ある。このため、高速デバイスや光デバイスに適した材 料として重要である。これらデバイスを作製するには、 従来は液相エピタキシャル成長法 (LPE 法)が用いられ ていたが、最近では、大面積に均一な結晶成長ができる 有機金属気相成長法(MOCVD 法)や分子線エピキタシ ャル成長法 (MBE 法)等が用いられるようになってきた。 特に MOCVD 法は、量産性に向くために、非常に注目を あびている。しかし、まだ完成された技術ではなく、残 された問題点もある。このうち,重要な問題点は, AsH3やPH3等の有毒ガスを原料として使用するために 危険性が伴うことである。成長装置には、もちろん十分 な安全対策が行われているが、完全ではない。原料自身 をより毒性の低いものに代えることが本質的な解決策と いえる。

MOCVD法のV族原料としては、当初から AsH3 や PH3

が用いられてきたが、最近では、危険性の低減のため、 液体で毒性の低い有機金属を用いる研究がなされてき た。AsH<sub>3</sub>に代わるものとして、 $(CH_3)_3$ As (トリメチル アルシン、TMAs)、 $(C_2H_5)_3$ As (トリエチルアルシン、 TEAs)、 $(C_2H_5)_2$ AsH (ジエチルアルシン、DEAsH)等 がある。このうち、DEAsH を用いた GaAs 成長において、 77K で64600cm/V・sの移動度が得られている<sup>1)</sup>。一方、 PH<sub>3</sub>に代わるものとして  $(CH_3)_2$ CH<sub>2</sub>CHPH<sub>2</sub> (イソブチ ルホスフィン、IBP)、 $(CH_3)_3$ CH<sub>2</sub> (タートブチルホス フィン、TBP)等がある。このうち、TBP を用いた InP 成 長では、300K で3100cm/V・s の移動度が得られている<sup>2)</sup>。 しかし、有機金属には、純度が良くない問題があり、さ らに原料の炭素が成長膜に取り込まれる恐れがある。

一方,他に固体元素を用いる方法がある。原料の純度 に関しては,MBE法等によく用いられているため,高 純度のものが容易に手に入る。しかし,固体砒素を用い たGaAs成長の報告によれば,Ⅲ族の有機金属から炭素 が成長膜に取り込まれてしまい,膜質を悪くする<sup>3)</sup>。そ こで,我々は,高純度の固体元素を用いて,炭素が成長 膜に取り込まれないようにするため,水素化物を結晶成 長時に生成させる方法を考案した<sup>4)</sup>。すなわち,結晶成 長時に固体元素を水素と反応させ,水素化物を生成し, これをV族原料として用いた。この方法では,成長を 行わない時は,V族原料は固体原料のままで,成長時の み,水素化物を生成するため,危険性が低い。さらに、 固体元素を用いているため、純度についての問題はない という特徴を持つ。

本論文では、固体元素を用いた成長ができるように作 製した MOCVD 装置とこの装置で成長させた InP の特性 について報告する。



Fig. 1 Schematic diagram of MOCVD system

## 2. MOCVD 装置

Fig.1に MOCVD 装置の配管図を示す。実際にはドー パントや他の原料の配管もあるが、ここではわかりやす くするために InP 成長に関したものだけを示してある。 また、この装置の外観写真を Fig.2に示す。MOCVD 装 置は(1)原料系、(2)配管系、(3)反応管系、(4)排気系、(5)制 御系から構成されている。以下、それぞれの構成部分に ついて説明する。

(1)原料系

InP成長の場合,Ⅲ族原料としては,(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>In(トリ メチルインジウム,TMI)を使用する。ステンレス製容 器に充塡されたTMIは,電子恒温槽によって一定温度 に保たれ,蒸気圧が制御されている。この容器中にキャ リアとしてH<sub>2</sub>を流すことによって,TMIの供給を行う。 一方,V族原料としては,本装置には,一般的なPH<sub>3</sub>と 赤リンが備わっている。PH<sub>3</sub>は,高圧ガスボンベから供 給を行う。本装置の特徴である赤リンは,6Nの純度で



Fig. 2 Photograph of MOCVD apparatus

ある数mmの粒状20gが石英管の中に入っている。この 固体原料部の外観写真をFig.3に示す。赤リンと水素か ら PH3を生成するために、プラズマを利用した。H2は、 そのままでは反応性がないので、マイクロ波プラズマに よって反応性の高いH原子を生成し、リンと反応させれ ば PH3が生成できる。また、リンとH原子が反応しや



Fig. 3 Photograph of the solid source for the group V element

すいように、赤リンを加熱し、リンの蒸気をプラズマ中 に入れた。この方法により、PH<sub>3</sub>が生成されることが 四重極質量分析計によって確認されている<sup>5)</sup>。この時マ イクロ波プラズマは、出力可変の2.45 GHz のマイクロ 波によって作る。マイクロ波は、マグネトロンによって 発生され、導波管を通して、減圧下の石英管まで伝えら れ、ここでプラズマを発生させる。

キャリアガスは、パラジウム透過膜式のH2精製装置 によって7Nに高純度化されたH2を用いる。

(2) 配 管 系

配管は、SUS316のステンレスチューブを用い、継手 には漏れがないように、VCR 継手を用いている。ガス の流量調整には、マスフローコントローラ (MFC)を 用い、しかも応答性の速いものを使用している。原料ガ スは、前もって、排気系に通じるバイパスラインに流し ておき、成長時にバルブによってキャリアラインに切り 換えて反応管に導入する。この切り換えバルブは、原料 ガスのたまりがない四方向バルブを用いた一体化マニホ ールドを使用している<sup>6)</sup>。これにより、急峻な界面が得 られる。また、Ⅲ族原料とV族原料は、配管途中での反 応をさせないように、別々の配管で反応管まで供給させ る。固体原料部から反応管までの配管は、圧力損失をな るべくなくすように、特別に1/2インチの径のステンレ スチューブを用いている。

(3) 反応管系

反応管周辺の写真をFig.4に示す。反応管は、石英 でできた横型のものである。基板は、反応管内のカーボ ンサセプタ上にガラストレーと共にのせる。基板加熱は、 赤外線ランブにより、下からカーボンサセプタを加熱す ることによって行う。この時成長温度は、カーボンサセ プタ内に挿入された熱電対によりモニターされ、設定温 度に制御される。また、基板交換時に、反応管内へ空気 が入るのを防ぐため、試料準備室を備えている。さらに 安定なV族原料の分解を促進するために、基板の直前に 高周波によってプラズマを発生させることができる<sup>7)</sup>。



Fig. 4 Photograph of the reactor

# (4) 排 気 系

プラズマを使用するため、1 Torr 前後での成長が可 能なように、排気系には、ロータリポンプ(RP)とメ カニカルブースタポンプ(MB)を備えた。圧力調整は、 H2流量、バタフライ弁の開度、N2流量の調整によって 手動で行う。排ガスは、未分解の有毒ガスを吸着剤(リ カゾール)で吸着除害した後、大気へ放出する。

また、ガス成分の分析が行えるように、反応管の後に、 ニードルバルブを介して、四重極質量分析装置をつなげた。これによって、赤リンとH2プラズマによって生成 されたガス成分の測定や成長時のガスモニタが可能である。

(5) 制 御 系

装置の制御盤では、各機器の運転、停止およびバルブ の開閉操作が行え、各ラインの流量や圧力などが常時モ ニタできる。また、万一の異常に備えた多くの警報イン タロック機能やコンピュータによる成長時の自動バルブ 開閉機能も備えている。

#### 3. PH<sub>3</sub>を用いた InP成長

一般的な InP 成長として、V 族原料に PH<sub>3</sub>を用いた。 この成長は、MOCVD 装置の性能をみるうえでも、ま た赤リンを用いた InP 成長と比較するうえでも参考にな る。成長圧力としては、一般的な圧力ではなく、後で述 べる赤リンを用いた成長と同じ1 Torr 前後とした。成 長条件は、Table 1 に示したとおりである。基板は、成 長前に有機洗浄を行った後、0.5% Br メチルアルコール で1分間エッチングを行った。

成長した試料の評価として,ノマルスキー顕微鏡によ る表面モホロジー観察,走査型電子顕微鏡による成長膜

Growth temperature	600 ~ 700°C		
Pressure	1. 2 ~ 1.7 Torr		
Total $H_2$ flow rate	490, 530cm³/min		
TMI flow rate (20°C)	°C) 50cm³/min		
V∕∭	600, 1000		
Substrate	(100) just or 2° off n-InP (100) just SI-InP		

Table 1 Growth conditions for InP grown using PH3

厚測定,プロファイルプロッタによるキャリア密度測定, Van der Pauw 法によるキャリア密度とホール移動度測定,及び77K でのホトルミネセンス測定を行った。 (1)表面モホロジー

成長温度とV/Ⅲ比を変えた時の表面モホロジーを Fig. 5 に示す。成長温度600℃では、やや曇った表面で あるが、それより温度を高くすると、鏡面が得られた。 また、V/Ⅲ比を1000にすれば、表面は平坦になる。 PH<sub>3</sub>の熱分解効率が低く、流速がかなり速いため、V/ Ⅲ比をかなり大きくしなければ、平坦な表面が得られな いことがわかる。





(2) 成長速度

成長速度と成長温度との関係をFig.6に示す。V/Ⅲ 比1000では、成長温度が650℃までは、成長速度はほぼ 一定であるが、700℃になると、リンの離脱が増すため、 減少する。また、V/Ⅲ比600では、PH<sub>3</sub>が少ないため600℃ の低温ではリンが減り成長速度が減少する。

(3) 電気的特性

キャリア密度と成長温度との関係をFig.7に示す。 V/Ⅲ比600では、成長温度を増すほど、キャリア密度が 減少する。これは、高温になるほど、PH<sub>3</sub>が分解しやす くなり、不純物が取り込まれにくくなるためである。一 方、V/Ⅲ比が1000と大きいとPH<sub>3</sub>が多いため、600℃ から700℃まで,キャリア密度の変化が少なく,2×10<sup>15</sup> cm<sup>-3</sup> 前後の低い値である。

ホール測定から,成長温度650℃,V/Ⅲ比1000の場合, 4.4μmの膜厚で,室温でキャリア密度が7.6×10<sup>14</sup>cm<sup>-3</sup>, ホール移動度が4900cm<sup>4</sup>/V·sである結果が得られた。 77Kでは、キャリア密度は、7.2×10<sup>14</sup>cm<sup>-3</sup>、ホール移動 度は87000cm<sup>4</sup>/V·sであった。比較的よい特性が得られた。



Fig. 6 Growth rate of InP layers grown using  $PH_3$  as a function of the growth temperature







Fig. 8 Photoluminescence spectrum at 77K from InP layers grown using PH<sub>3</sub>

(4) ホトルミネセンス特性

成長温度650℃、V/Ⅲ比1000の成長条件で成長した InPのホトルミネセンス特性をFig.8に示す。878nmの ピークは、バンド間遷移からの発光である。このピーク の半値幅は8.7meV である。成長温度600℃から700℃ま では、同様なスペクトルが得られた。

## 4. 赤リンを用いた InP 成長

赤リンを用いた InP の成長条件を Table 2 に示す。成 長した試料の評価は、3 で述べたものと同じである。

(1) 表面モホロジー

成長温度と V/Ⅲ比を変えたときの表面モホロジーを Fig. 9 に示す。成長温度が600℃では鏡面が得られるが、

**Table 2** Growth conditions for InP grown using red-<br/>phosphorus and  $H_2$  plasma

Growth temperature	550 ∼ 650°C
Pressure	1. 2 Torr
Total H <sub>2</sub> flow rate	600cm²/min
TMI flow rate (20°C)	50cm³/min
Temperature of red-phosphorus	410, 435°C
H <sub>2</sub> flow rate through red-phosphorus	200cm²/min
Plasma Power	40, 100W
Substrate	(100) just or 2° off n-InP (100) just SI-InP

これより温度を上げると、表面が荒れ、曇ってくる。ま た、試料表面はプラズマパワーに大きく変化し、100W 以上に上げると荒れてくる。これは、リンがプラズマに よって石英管や配管に多く付着してしまい、基板まで達 するリンが少なくなるためであると考えられる。しかし 500℃以下の低温では、平坦な表面が得られた。

## (2) 成長速度

成長速度と成長温度の関係を Fig.10に示す。赤リン の蒸気で成長した InP の成長速度は,600℃と650℃では, ほぼ一定である。一方,プラズマを使用すると違う。600℃ では赤リンの温度を上げると,大きく成長速度が増し, 650℃ではあまり変化しない。これは,Fig.6 に示した PH<sub>3</sub>の場合に似ている。赤リンの温度を上げることによ って,PH<sub>3</sub>が増すためであると考えられる。

(3) 電気的特性

キャリア密度と成長温度との関係を Fig.11に示す。 成長温度550℃以下の試料は、鏡面な表面であるが、キ ャリア密度の測定ができなかった。600℃以上では赤リ ンの蒸気で成長した試料のキャリア密度は、1×10<sup>16</sup>cm<sup>-3</sup> と一定である。しかし、プラズマを使用した試料では、 成長温度600℃では減少し、650℃では増加する。この現 象は現在のところ原因がまだわかっていない。

ホール測定からは、成長温度650℃、赤リン温度435℃ の場合、4.0 μmの膜厚で、Table 3の結果を得た。 Fig.11と同様に、プラズマを使用した場合、キャリア密 度が増加し、ホール移動度が減少する。

(4) ホトルミネセンス特性

成長温度650℃,赤リン温度410℃の成長条件で成長したInPのホトルミネセンス特性をFig.12に示す。赤リ



Nomarski photomicrograph of InP layers grown using red-phosphorus Fig. 9 and H2 plasma at various growth temperatures and plasma powers



Fig. 10 Growth rate of InP layers grown using redphosphorus and H2 plasma as a function of the growth temperature

Table 3 Result of Hall measurements for InP layers using red-phosphorus and H2 plasma

carrier		Hall mobility (cm²/Vs)	
Plasma	(cm <sup>-3</sup> )	300K	77K
0 W	$4 \times 10^{-16}$	1500	7100
40 W	$8 \times 10^{-10}$	1700	2800

ンの蒸気で成長した試料では、PH3の場合に比べて強度 が小さいが、半値幅は8.7meVと同じである。一方、プ ラズマを使用した場合、半値幅は15meVとかなり大き い。これは電気的特性からもわかるように、不純物が取 り込まれているためである。また,600℃以下で成長し



Fig. 11 Carrier concentration of InP layers grown using red-phosphorus and H2 plasma as a function of the growth temperature

た試料も測定したが、ホトルミネセンスのピークが現れ なかった。欠陥が多いためと考えられる。

#### 5.まとめ

固体原料を用いた成長ができる MOCVD 装置と、この 装置で成長した InP の特性について述べた。

固体原料を用いた MOCVD 成長の特徴は、次の点であ ろ。

(1) 毒性の低い固体原料を使用するため、危険性が低 V10

(2) 固体原料は蒸気圧が低いので,漏れる恐れがない。

(3) 高純度の固体原料が容易に手にはいる。



Fig. 12 Photoluminescence spectra at 77K from InP layers grown using red-phosphorus and H<sub>2</sub> plasma

InP成長の結果では、PH<sub>3</sub>を用いた場合、77Kでキャ リア密度7.2×10<sup>14</sup> cm<sup>-3</sup>、ホール移動度87000 cm<sup>2</sup>/V·sの 良好な InP が成長できた。赤リンを用いた場合には、赤 リンの蒸気を用いた成長で、77Kでキャリア密度1.6× 10<sup>16</sup> cm<sup>-3</sup>、ホール移動度7100 cm<sup>2</sup>/V·s の特性が得られた。 しかし、プラズマを使用すると、不純物が成長膜に取り 込まれ、膜質が悪化した。

今後は、膜質悪化の原因を調べ、良質な結晶が得られ る条件を見い出すことが必要である。

本研究に協力いただいた板倉秀明君と田中啓司君に感 謝致します。

# 1 文 1 文

- R. Bhat, M. A. Koza and B. J. Skromme : Appl. Phys. Lett. 50 (1987)1194
- 2) C. H. Chen, C. A. Larsen, G. B. Stringfellow, D. W. Brown and A. J. Robertson : J. Cryst. Growth 77 (1986)11
- 3) R. Bhat : J. Electron. Mater. 14 (1985) 433
- 4 ) M. Naitoh and M. Umeno : Jpn. J. Appl. Phys. 26 (1987) L1538
- 5)内藤正美, 鈴木孝之, 曽我哲夫, 神保孝志, 梅野正 義:電気学会研究会資料 EFM-87-31 (1987)9
- 6)伊東和彦,植松邦全,山崎利明:日本酸素技報 6 (1988)3
- 7)内藤正美,鈴木孝之,曽我哲夫,神保孝志,梅野正義:電子情報通信学会技術研究報告 ED88-29 (1988)49